

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-04-001

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（线上会议）
参与单位	<p>财通基金、华夏基金、中金基金、摩根士丹利基金、南方基金、东方阿尔法基金、方正富邦基金、嘉实基金、交银施罗德基金、金鹰基金、鹏华基金、创金合信基金、国寿安保基金、汇泉基金、深圳惠通基金、深圳金之灏基金、太平基金、盈米基金、长盛基金、海南悦溪私募基金、鸿运私募基金、明世伙伴私募基金、上海翀云私募基金、上海合远私募基金、富博领航私募证券投资基金、涌瑞私募基金、粤民投私募证券投资基金、昭华（三亚）私募基金、中合鼎盛（北京）私募基金、遵道资管、财通证券资管、大家资管、广发证券资管、华夏久盈资管、马可孛罗至真资管、平安资管、上海东方证券资管、上海宁泉资管、上海睿郡资管、上海深积资管、上海世诚资管、上海循理资管、深圳前海旭鑫资管、招商证券资管、浙江米仓资管、深圳创富兆业、星石投资、淡水泉(北京)投资、耕霖(上海)投资、杭州乐信投资、弘则弥道(上海)投资、江苏瑞华投资、上海博笃投资、上海道翼投资、上海泾溪投资、上海明河投资、深圳鑫然投资、五矿鑫扬投资、友邦投资、浙江版图投资、中金公司、瑞士银行、华能贵诚信托、华杉瑞联、亚太财保、中新融创资本、海通国际、广西赢舟管理咨询、和谐健康保险、凯盛融英、纳弗斯、中信建投证券、中信证券、中银国际证券、中银证券、安信证券、财通证券、德邦证券、第一创业证券、东北证券、东财证券、东方证券、东海证券、东吴证券、东亚前海证券、方正证券、光大证券、广发证券、国海证券、国联证券、国盛证券、国投证券、国信证券、国元证券、海通证券、华福证券、华泰证券、华鑫证券、汇丰前海证券、开源证券、凯基证券、民生证券、上海申银万国、上海证券、西部证券、西南证券、兴业证券、野村东方国际证券、粤开证券、长城证券、长江证券、招商证券、浙商证券、银河证券、中泰证券、中原证券、个人投资者（排名不分先后）</p>
时间	2024年4月25日9:00

<p>上市公司接待 人员姓名</p>	<p>副总经理、董事会秘书：蒋威 证券投资部：王渝、陈小曼、陈卓璜</p>
<p>投资者关系活 动主要内容介 绍</p>	<p>一、公司 2023 年度及 2024 年第一季度业绩情况介绍</p> <p>2023年度，公司实现营业收入535,992.39万元，较上年同期增长0.11%，基本持平，主要系行业整体下滑和竞争加剧导致需求不足。归属于上市公司股东的净利润为21,121.20万元，较上年同期下降59.82%，主要系FCBGA封装基板项目的费用投入和珠海兴科CSP封装基板产能爬坡阶段的亏损，其中FCBGA封装基板业务（包括珠海工厂和广州工厂）全年费用投入39,594.00万元，珠海兴科项目全年亏损6,625.30万元。</p> <p>报告期末总资产1,493,539.87万元，较上年末增长25.55%；归属于上市公司股东的所有者权益533,394.01万元，较上年末下降18.42%；资产负债率为57.77%，较上年末上升16.86个百分点，主要系因FCBGA封装基板项目投入、并购北京兴斐导致负债规模增加，且因广州兴森半导体有限公司FCBGA封装基板项目引入战略股东，上市公司对其少数股东股权有远期收购义务，根据相关规定确认其他非流动负债12.6亿元。</p> <p>2024年第一季度实现营业收入138,846.70万元、较上年同期增长10.92%，归属于上市公司股东的净利润为2,482.27万元，扣非归母净利润2,392.66万元，FCBGA封装基板项目的费用投入对当期净利润产生较大拖累。</p> <p>二、行业情况简介</p> <p>2023年PCB行业整体规模为695.17亿美元、同比下滑15%，是过去十年最为惨淡的一年，四个季度同比增速分别为-20.7%、-18.9%、-13.4%、-6.2%。行业主要问题在于需求疲软、供给过剩，以及下游行业去库存，导致整体竞争加剧、价格内卷。</p> <p>从产品结构看，所有细分产品领域都是下滑的，封装基板受半导体行业去库存影响量价齐跌，下滑幅度最大，同比下降28.2%。根据公开信息，台湾载板厂商（欣兴电子、景硕科技、南亚）2023年营业收入平均下滑幅度在30-40%之间，以高多层高速版、HDI板为代表的TTM、华通电脑表现略好，下滑幅度较小。</p> <p>从主要下游看，根据Prismark数据，晶圆代工整体下滑12.1%，封装</p>

行业下滑15.1%，半导体器件行业下滑8.6%，存储芯片下滑35%。从2023年第四季度看，这些领域全面回暖。2023年行业的结构性机会在于AI算力和智能驾驶领域，对于高多层高速板、高阶HDI板需求有明显拉动。经历相对充分的去库存，下游主要终端的库存压力显著缓解，预期2024年PCB行业将实现恢复性增长，整体规模达到730亿美元、同比增长4.97%。未来5年，行业整体规模预期达到904亿美元，2023-2028年复合增长率为5.4%。普通多层板市场供过于求、竞争激烈的状况难有实质性缓解，主要的机会仍在于AI、高速网络、智能驾驶等对于高端产品的需求拉动。

三、FCBGA封装基板项目的进展情况

公司FCBGA封装基板项目为公司战略性投资，截至2023年底累计投资规模超过26亿元、截至2024年3月底累计投资规模约30亿元，工厂审核、产品认证、市场开拓等各项工作正按计划推进。

公司珠海FCBGA封装基板项目部分大客户对工厂的技术评级、体系认证以及对产品的可靠性验证均已通过，目前低层板良率提升至90%、高层板良率提升至85%以上，珠海厂已有少量样品订单收入，金额较小，预期第二季度开始小批量量产。

广州FCBGA封装基板项目于3月中旬通过工厂技术评级，计划5月上旬完成体系评级，之后进行产品认证，预期8月底前后完成产品认证开始量产，比原计划提前一个月左右，公司将继续开展FCBGA业务拓展工作。

四、CSP封装基板业务介绍

公司CSP封装基板2023年度共实现收入8.2亿元，广州工厂和珠海工厂合计共有3.5万平方米/月产能（广州工厂2万平方米/月、珠海工厂1.5万平方米/月），截至2023年底，广州工厂实现满产，珠海工厂产能利用率约60%。下游应用占比如下：存储类占比约70%，应用处理器芯片、传感器芯片、射频芯片等其他相关占比约30%，预计未来将维持前述产品结构。客户占比情况如下：国内客户占比约55%，台湾客户占比约20%，国外客户占比约25%，下游国内厂商正在积极扩产，是未来的增量市场所在，公司将根据市场恢复情况适时启动扩产计划。

五、公司传统PCB业务介绍

2023年度公司PCB业务实现收入409,050.23万元、同比增长1.5%，毛利率28.72%、同比下降1.57个百分点。

	<p>公司传统PCB业务产能未有扩产计划，产能维持不变，未来重点将放在数字化转型，加快从“制造”到“智造”转型的步伐，提升竞争力，实现平稳增长。</p> <p>六、北京兴斐电子有限公司情况介绍</p> <p>北京兴斐已于2023年7月纳入公司合并报表，并已完成对核心团队的股权激励，目前资产、业务等整合工作已全面展开，业务拓展工作稳步推进，除国内外主流手机品牌客户之外，FCCSP基板和采用BT材质的FCBGA基板已实现批量交付，应用于高端光模块领域的类载板产品认证工作也已启动并顺利开展。</p> <p>北京兴斐2023年全年实现营业收入7.46亿元，合并报表期间贡献收入38,920.89万元，净利润6,098.17万元。在手机领域主要客户以韩系和国内主流手机品牌为主，2024年的主要目标是提升在主要客户中的份额，同时实现光模块领域的产品放量。</p>
附件清单	无
日期	2024年4月25日